

# 征文 通知

## 2022年机械电子学学术会议

—— 中国·成都

中国电子学会电子机械工程分会拟于2022年10月在四川省成都市召开2022年机械电子学学术会议。本次会议旨在交流机械电子专业领域的新技术、新思想和新成果，洞察机械电子领域的最新动向，从而促进机械电子技术的进步与创新，以及机电一体化领域的学术交流。热忱欢迎业界专家、学者、企业家、分会委员及会员积极组稿、撰稿并参加会议进行交流。现就会议征文有关事宜通知如下：

### 征文范围 (包括但不限于以下领域)

<b>A</b> 电子装备的机电耦合 A1. 多场耦合建模 A2. 机电耦合分析 A3. 机电耦合设计技术	<b>B</b> 机械电子设计 B1. 工程机械设计 B5. 柔性电子设计 B2. 工业设计 B6. 轻量化设计 B3. 电子封装设计 B7. 智能化设计 B4. 结构-性能-功能一体化机器人设计	<b>C</b> 先进制造技术 C1. 智能制造 C4. 微纳制造 C2. 数字孪生 C5. 复合材料成型技术 C3. 增材制造 C6. 喷射成型技术	<b>D</b> 电子装备的环境适应性设计 D1. 热设计 D2. 振动控制 D3. 电磁兼容设计 D4. 可靠性工程
<b>E</b> 检测传感技术 E1. 机电系统中的传感与测量 E2. 无损检测与评估 E3. 机器视觉和图像处理 E4. 智能传感与测控	<b>F</b> 微纳机电系统及机器人 F1. 微型和纳米机电 F2. 微传感器和微作动器 F3. 机电系统中的机电一体化 F4. 机器人技术及自动控制	<b>G</b> 电子装备智能化研究热点或新方向 G1. 空间太阳能电站 G2. 无线电能传输技术 G3. 智能汽车与车联网 G4. 能源互联网技术 G5. 人工智能在机电与能源交叉领域应用技术	<b>H</b> 医工结合交叉研究热点或新方向 H1. 生物制造 H2. 生机电一体化智能装备或系统 H3. 生物传感技术

### 征文投稿方式



会议征文全文投稿请以word版电子文件在论文系统上提交。

扫描左侧二维码 或 [点击这里进入论文系统](#)



征文电子版文件名为“第一作者姓名-文章题目-所选择的征文范围”，论文符合会议征文模板格式要求，并于文章最后注明手机号码、邮箱、单位/学校、通讯地址。

扫描左侧二维码 或 [点击这里下载会议征文模板](#)

### 征文要求

论文应有所创新、论点明确、论据充分。采用国际标准计量单位，未曾在国内外公开发行的刊物上发表。本次论文集不正式出版，以电子版形式发放。遴选的论文将推荐在《电子机械工程》、《现代雷达》、《中国电子科学研究院学报》上刊登。

论文的保密审查由各单位自行负责，请作者将经单位盖章的《稿件保密及原创性事项审核表》扫描形成PDF文档和全文一起在论文系统作为论文附件提交。



扫描左侧二维码

或 [点击这里下载会议保密审查模板](#)

### 重要日期

▶ 论文投稿截止：2022年7月26日

▶ 发布录用通知：2022年8月30日

### 联系方式

▶ 联系人：李秘书（会务组）- 135 4003 2551

黄老师（电子机械工程分会）- 025-51824213/13913022253

▶ 电子邮箱：eme2022@yaang.cn